

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 线上交流 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	平安基金、鹏华基金、诺安基金、长城基金、富国基金、银华基金、浦银安盛基金、中信保诚、国泰基金、国联基金、景顺长城、中银基金、中融基金、金鹰基金、华安基金、宏利基金、淳厚基金、创金合信基金、申万菱信基金、华泰资产管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、中兴资本、中金公司、国泰海通、中邮证券、中泰证券、野村东方国际证券、西部证券、申万宏源、山西证券、平安证券、民生证券、国元证券、大和证券、观富（北京）资产管理有限公司、浙江益恒投资管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、深圳市优美利投资管理有限公司、深圳市圣为投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海煜德投资管理中心（有限合伙）、上海行知创业投资有限公司、上海微丰投资管理合伙企业（有限合伙）、上海天猊投资管理有限公司、上海申九资产管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、开弦资本管理有限公司、华宝信托投资有限责任公司、杭州遂玖资产管理有限公司、北京颐和久富投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京厚特投资有限公司、北京富纳投资有限公司、中信银行股份有限公司、WILLING CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、Dancheng Investment 等 58 家机构
时间	2026 年 4 月 27 日-2026 年 5 月 9 日

地点	现场交流、公司会议室
公司接待人员	1、董事会秘书、财务总监 陆春龙 2、证券事务代表 李妍君
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司概况</p> <p>广立微是领先的 EDA 软件、PDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，聚焦芯片成品率提升与电性测试快速监控业务，同时布局光子芯片设计技术，是国内外多家大型集成电路企业的重要合作伙伴。公司提供 EDA 软件、PDA 软件、电路 IP、WAT 测试设备及成品率提升全流程解决方案，贯穿集成电路设计至量产全周期，助力提升芯片性能、成品率与稳定性，成功案例覆盖多个集成电路先进工艺节点。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、请简要介绍一下公司 2025 年度的业务收入表现？</p> <p>2025 年度，公司实现营业收入 73,497.73 万元，同比增长 34.40%，其中软件开发及授权业务收入 27,810.22 万元，同比增长 75.13%，占营收比重由上年的 29.04%提升至 37.84%；测试设备及配件业务收入 45,331.92 万元，同比增长 17.30%，占营收比重由上年的 70.66%下降至 61.68%。整体来看，软件业务高速增长带动收入结构持续优化，软硬件协同发展的格局进一步巩固。</p> <p>2、从 2025 年报来看，公司软件业务实现了大幅增长，请问 LUCEDA 并表后对公司业绩的贡献如何？目前技术整合进度是否符合公司预期？</p> <p>2025 年公司境外收入 2,208.42 万元，同比增长 78.66%，主要是 LUCEDA 的并表影响，LUCEDA 在全球硅光 PDA 领域拥有成熟的业务体系，使公司客户群体快速扩大至欧美市场。在业绩贡献方面，鉴于公司硅光业务尚处于战略布局与技术整合的早期阶段，以及 LUCEDA 并表仅覆盖 8 月至 12 月不足 5 个月，因此对公司整体营收贡献不显著。</p> <p>在整合进度方面，2025 年 8 月 12 日本次并购正式完成交割，此后的价格调整、评估审计公司也如期推进完成，管理与业务整</p>

合符合公司整体预期，此外双方也着力推进协同研发，2025 年 LUCEDA 发布了业界首款硅光异质异构集成 PDK，并与公司合作推出了 DE-Photonics 和 Photonics DRC 工具，业务协同进展高效。

3、年报显示公司 2025 年前五大客户销售占比达 72.37%，客户集中度风险如何应对？

公司客户集中度较高，这主要由于公司下游客户以晶圆厂为主，晶圆厂总体集中度较高，公司与主流晶圆厂在测试芯片设计、WAT 测试设备、数据分析等环节形成深度绑定，客户黏性较强。为分散客户集中风险，公司采取多维举措：一是拓展产品品类，从原有良率提升方案延伸至 DFT、DFM、半导体大数据、硅光 PDA 等领域，开拓 Fabless、存算一体等新客户群体；二是加强多元化市场开拓，2025 年公司大数据软件首次实现海外销售，并购 Luceda 后海外销售渠道也进一步拓宽。随着产品矩阵扩容和新市场打开，公司客户结构将进一步改善，集中度风险有望逐步缓解。

4、请问公司在 AI 融合方面的具体布局是什么？2025 年有什么进展？

公司已将 AI 技术融合确立为核心战略方向，2025 年在三个层面取得实质性进展：第一，产品智能化升级——公司全面推进大数据软件与 AI、LLM 大模型的深度融合，自研的 SemiMind 半导体大模型平台已成功接入 DE-G 和 INF-AI，实现知识库驱动的智能问答与根因分析，显著提升工程师的分析效率。第二，推出 AI 原生工具矩阵——公司不断丰富“AI 智能+LLM 大模型”工具集，涵盖 ADC（自动缺陷分类）、WPA（晶圆缺陷图案分析）、VM（虚拟量测）、TPC（机台原始数据监控）等产品，覆盖缺陷识别、良率预测、设备预警等智能制造全场景；2025 年新推出 QuickRoot（智能根因溯源）、iMetrology（SEM/TEM 在线智能量测）、iCASE（智能案例档案）等新品，全方位赋能良率提升与缺陷溯源。第三，内部研发提效——公司内部已发布 AI 编程助

	手，助力研发团队提质提效。未来公司将持续深化 AI 融合，驱动工具与平台智能化升级，为长期增长注入新动能。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2026 年 5 月 9 日